

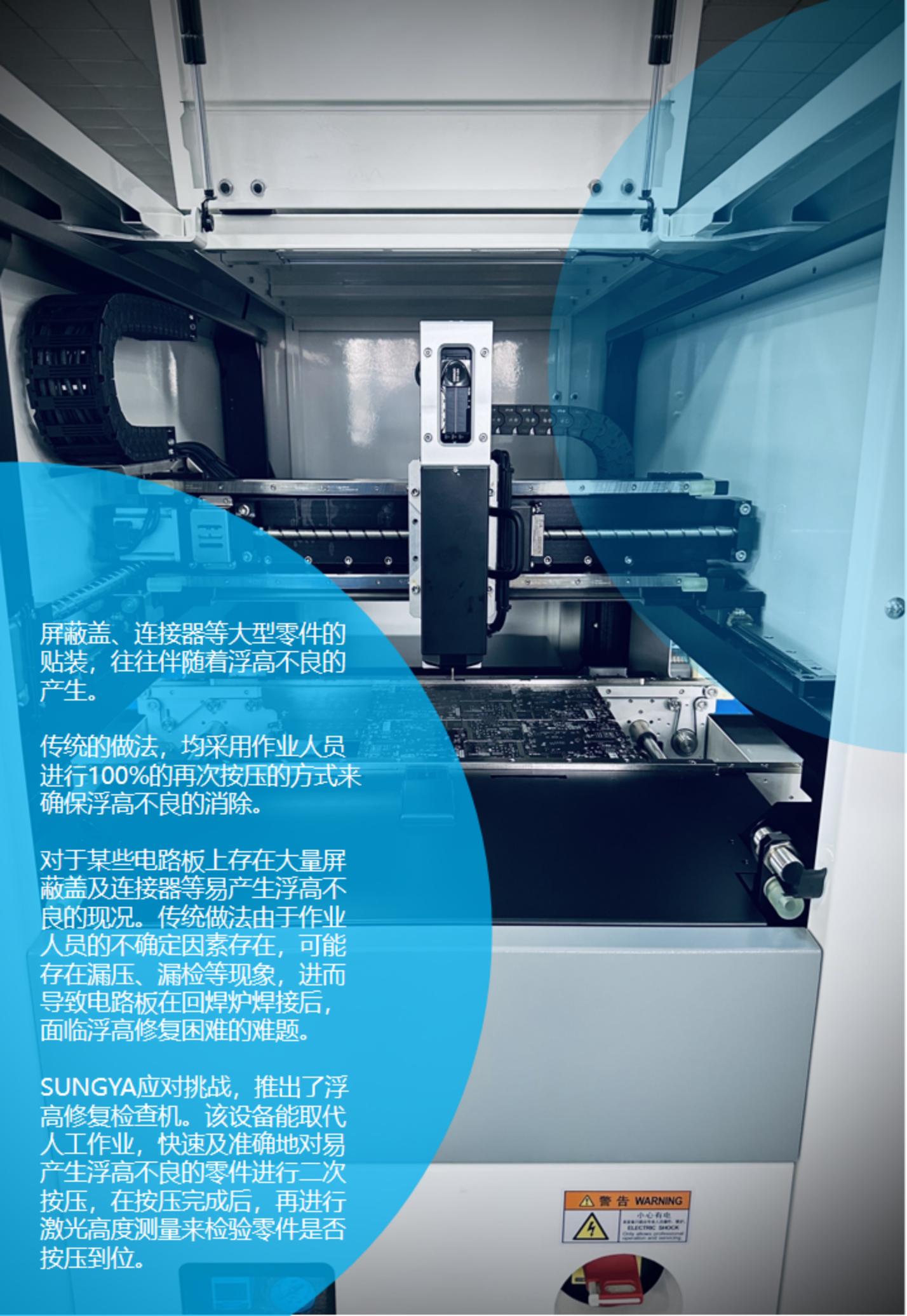
SUNGYA

浮高修复检查机

浮高修复、检查在一台机器上实现

浮高不良的处理变得更加简单





屏蔽盖、连接器等大型零件的贴装，往往伴随着浮高不良的产生。

传统的做法，均采用作业人员进行100%的再次按压的方式来确保浮高不良的消除。

对于某些电路板上存在大量屏蔽盖及连接器等易产生浮高不良的现况。传统做法由于作业人员的不确定因素存在，可能存在漏压、漏检等现象，进而导致电路板在回焊炉焊接后，面临浮高修复困难的难题。

SUNGYA应对挑战，推出了浮高修复检查机。该设备能取代人工作业，快速及准确地对易产生浮高不良的零件进行二次按压，在按压完成后，再进行激光高度测量来检验零件是否按压到位。



产品优势

- 取代人工作业，节省人力资源
- 可控的按压力，确保不会过压造成零件移位
- 高速高精度的按压
- 使用高精度激光传感器检查零件是否浮高
- 不同电路板应对快速转换，快速调整
- 基于机器视觉图形编程，生产程序的编写更容易

速度更快、精度更高

FHD系列设备具备比作业人员更快的修复速度，更高的检查精度的优点。

以及节省现场作业人员的人力配备，是制造工厂批量生产中传统作业方式的优异替代方案。

最大限度地减少了炉后浮高不良的电路板修复工作量。

设备配备的激光高度测量功能，可在可行的情况下衍生为其它与高度测量相关的应用。

基于松亚新一代NIAP平台

配备高速高精度的运动控制系统，几乎所有的运动部件均由软件自动驱动，无需作业人员的干预，仅需在设备检出设备无法修复的浮高不良时才需要作业人员介入。

FHD全系列配备基准点视觉识别以消除误差。

配备的高精度激光高度测量在软件层面的算法辅助下自动补偿电路板的翘曲变形，从而保证测量数据的准确性。

基于松亚新一代NIAP平台，保证了设备的紧凑性，在更小的体积内支援更大的电路板。



智能的自动化控制软件

所有的硬件均100%由软件驱动

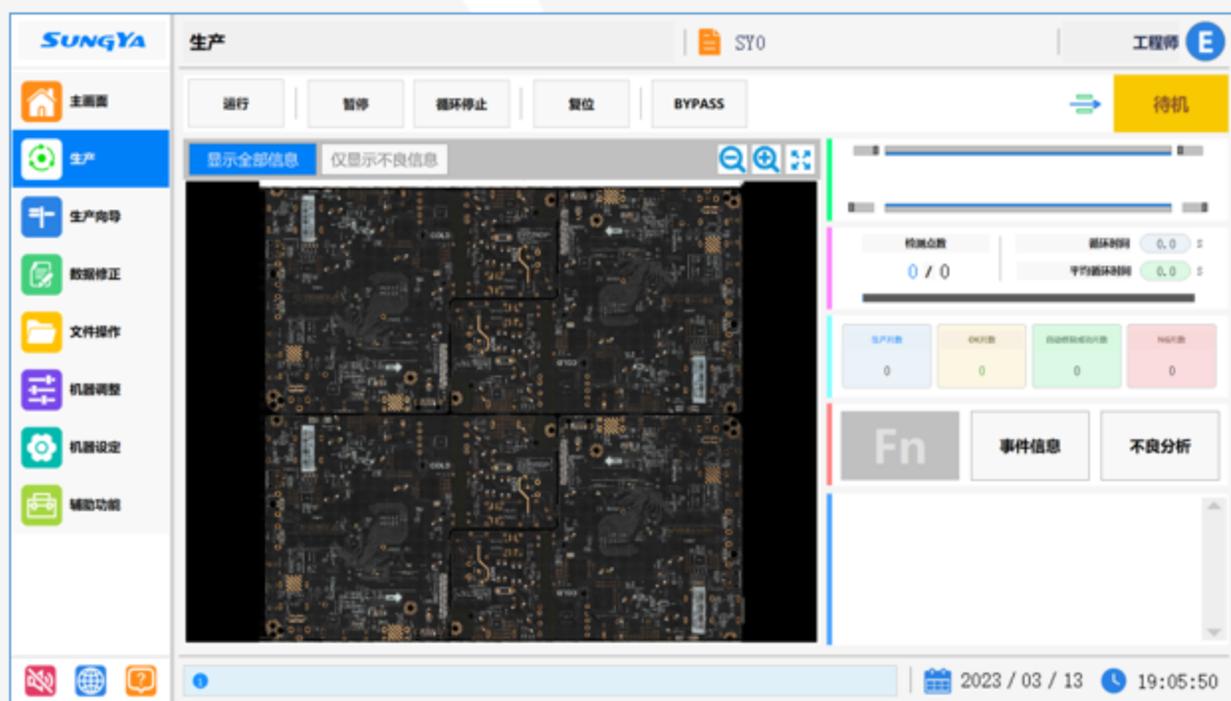
FHD系列设备是100%由软件驱动的，包含轨道宽度的调节，故允许在更短的时间内完成换线工作。

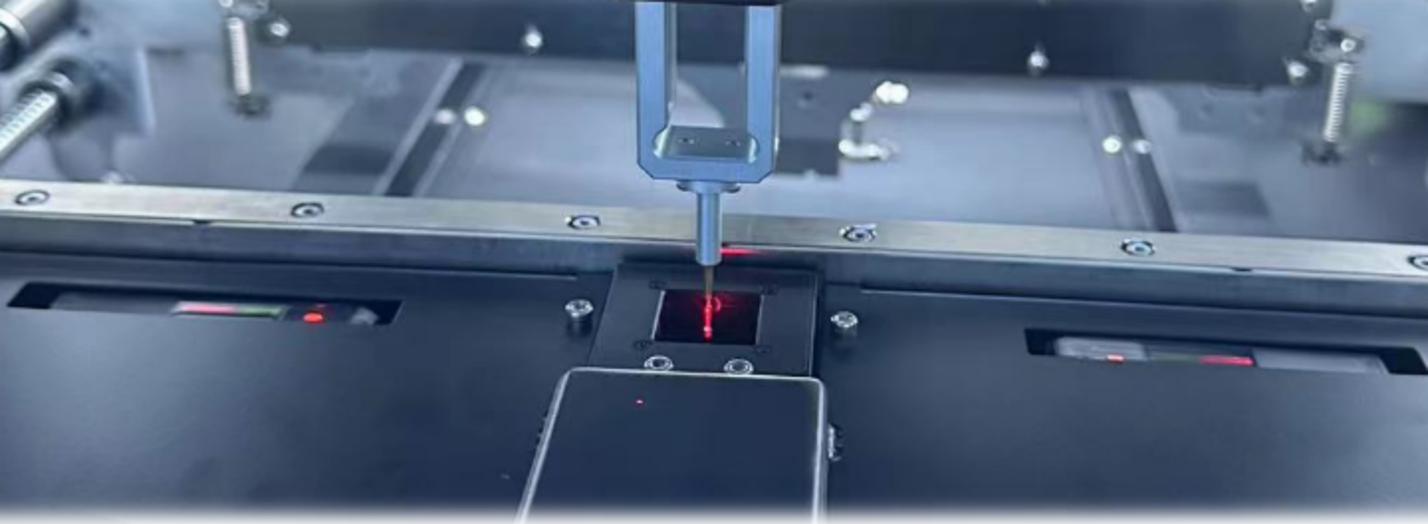
软件采用向导模式，尽可能傻瓜化。

无论是生产前的准备，生产程序的编辑等，我们均站在客户端现场作业人员的角度并结合我们多年的行业经验来进行控制软件的开发。

从而保证了FHD系列设备可以更容易地集成到一个完全自动化的生产线。

打开记录每个电路板的条码功能，连入现场的MES系统，将确保您的生产记录具备可追溯性。





两个高速型号可选(基本型)

提供两个基本型号的选择，以及接受定制

FHD800SL

单轨型，支援最大460mm*460mm的电路板

FHD900SL

单轨型，支援最大550mm*460mm的电路板

FHD***DL (定制机型)

双轨型，及更大的电路板支援尺寸可选



主要技术指标

- 电路板类型：硬板、带治具的软板
- 运动平台：龙门式XY, Z
- 最大移动速度：1000mm/s
- 传送系统方向：从左至右(出厂设定)，从右到左(软件设定)
- 传送系统高度：900±20mm
- 针对元器件：屏蔽盖，连接器等
- 电气需求：AC220 50/60HZ、≥0.4Mpa



籍由我们的行业经验，此机器助力于生产线的无人化，消除人工作业的不确定性。直击行业痛点。

如果您的工厂有此方面的需求，请即时联系我们！



SUNGYA

Create innovative electronics products together!

昆山松亚电子科技有限公司

联系电话: +86 0512 57567823

电子邮箱: sungya@sungya.com

地址: 江苏省昆山市古城北路438号 (松亚智能产业园)